

## 株式会社アドバンテスト

### 2021年3月期(2020年度)決算説明会 質疑応答要旨

2021年4月27日(火)

- Q: 半導体の前工程装置市場では、複数の大手半導体メーカーの投資増計画など、今後期待できるイベントが年末年始にかけ複数見込まれている。テスト市場に関してはいかがか。足元で御社は絶好調であるが、御社に対する期待感を今後しばらく先までサポートするようなエビデンスがあれば、追加で伺いたい。
- A: SoC テスタは年度を通じて好調が継続すると見ている。年度前半には 5G スマートフォン関連で良好な事業環境を見込んでいる。さらに年度後半には当社の主要顧客群が最先端プロセスを用いたデバイスの量産に入ることで、大きなテスト需要が喚起されることを期待している。メモリ・テストでは、顧客の生産能力向上に見合ったテスト投資が期待できるほか、DRAM 微細化や NAND フラッシュメモリ多層化に伴う大容量化の進展、高速な DDR5/LPDDR5-DRAM の本格量産開始などの業界動向が見込まれる。メモリ・テストについても良好な需要推移が期待できる。
- Q: 現在、工場のキャパシティはどのくらい先まで埋まっているか。
- A: 足元の需要は非常に強く、目下、生産現場は非常に繁忙な状態。当社のリードタイムは3ヶ月であるが、そこまでのロットは埋まっていて、リードタイムは伸びていく傾向にある。そのことが顧客のテスト発注の前倒しにつながっているのではないかと懸念はあるが、足元の状況を見ると必ずしもそうではないようだ。現状、実需に基づいた健全な発注をいただいていると認識している。
- Q: 御社に関しては、システムレベル・テストへの参入や DRAM テスタの更新需要の取り込みなど、御社固有の成長ドライバーがここ数年相次いできた。今期に関してはいかがか。業績インパクトのある有望な新製品投入の予定などはあるか。
- A: テクノロジーの進化とともに半導体の複雑化が進展し、それがテストに対する要求を増やし続けるという業界の構造は不変。そうした中、今後の新製品ではないが、5nm 以下の先端プロセス品のテストニーズに応える「V93000 EXA Scale」を当社は昨年発表済。その製品への需要が今年度増加していくと考えている。また、CMOS イメージセンサー向けやディスプレイ・ドライバーIC 向けなど、今後の期待の高い製品はいろいろある。
- Q: テスタ市場規模を前回1月時点の見通しから引き上げている。SoC テスタとメモリ・テスト、それぞれどの領域の見通しを修正したのか教えて欲しい。また、SoC テスタに関してはさらに市場拡大する可能性についても言及していたが、どのアプリケーションで上振れ可能性を想定しているかも教えて欲しい。

- A: 暦年 21 年の SoC テスタ市場見通しに関しては、スマートフォンや HPC 関連の先端プロセス品の増加見通し、アナログ半導体のテスタ需要の拡大可能性、ディスプレイ・ドライバーIC の高機能化の進展、主にこの3つの領域の需要動向を踏まえ、市場予想を 3.4B 米ドルへ増額した。年度後半の HPC を中心とした先端プロセス品に関しては、需要上振れの可能性も見ている。メモリ・テスタ市場の方は、1 月時点の見通しと方向性は大きく変わっていない。DRAM や不揮発性メモリに対する微細化、大容量化、高速化の進展によるテスタ需要の増加ペースを踏まえ、3 ヶ月前の数字から 100M 米ドルを追加した、1.3B 米ドルの市場サイズと推定している。
- Q: 20 年度のサービスその他セグメントにおけるシステムレベル・テスト(SLT)事業の受注/売上構成比、および 21 年度の受注/売上の方向感などをご教示いただきたい。
- A: サービスその他セグメント内の SLT の受注/売上構成比は、20 年度、21 年度ともにそれぞれ 5 割程度。半導体の進化に伴う品質保証の重要性上昇を背景に、SLT に対する業界としての取り組み深度はいつそう深まっている。そうした環境下、スマートフォン、HPC、そして車載まで、SLT の対象の裾野の広がりとともに受注/売上の数字も伸びていくと考えている。
- Q: 受注/売上高 3,500 億円の通期ガイダンスを示されているが、今後の受注の方向感について、足元の状況も含めて教えて欲しい。
- A: 4Q の受注は非常に強かった。強い四半期の後は受注が下がることも多いが、足元 1Q に関しては、今のところ落ちる気配は感じ取れていない。3,500 億円の通期受注高計画については、上期が好調な分、上期の方が若干多めという見方をしている。ただリードタイムの関係で、下期の受注見込みに関しては、まだジビリティが十分ではない。直前にならないとなかなか顧客の状況を掴めず、計画に織り込みにくい面がある。先端プロセス関連の顧客の下期の動向がだんだんと分かってくれば、受注がもう少し増える可能性もある。
- Q: どのくらいの四半期受注/売上水準まで現状の生産体制で対応可能か。また部材不足リスクに対する対策状況などもお示しいただきたい。
- A: 当社は日本国内、海外とも、自社工場とアウトソースを併用した生産体制。足元もそれほど逼迫感はなく、またアウトソース活用を増やすことでまだまだ能力拡張可能。当社の中長期経営方針「グランドデザイン」のターゲットである売上高 4,000 億円、つまり四半期売上 1,000 億円水準をサポートするレベルの生産体制構築に際して、それほど懸念はない。部材調達面に関しては、問題が顕在化しないよう、前広な対応に努めている。これが実り、現状大きな問題にはなっていない。
- Q: 再確認したいが、足元の受注には顧客の二重発注などはなく、実需に基づいたものと御社は認識しているという理解で良いか。

A: 二重発注に対する警戒感が業界内にあるのは承知している。ただし今までのところは健全な需要に基づく受注だと考えている。顧客からのキャンセルの動きも全くない。

Q: 暦年 21 年の SoC テスタ市場を 3.4B 米ドルとすると、21 年度の SoC テスタ売上予想は 1,690 億円なので、暦年と会計年度の差があるものの、単純計算では御社の市場シェアは 50%を切る計算になる。暦年 21 年はスマホや HPC といった御社の得意な分野で需要が伸びることを考えると、御社の業績予想が保守的過ぎるようにも映る。もしくは、市場シェアが過去の水準まで回復しない可能性があるのか。

A: ご推察のとおり、暦年と会計年度のギャップが当社シェアの見え方に影響しています。

Q: 21 年度下期に HPC 関連顧客の先端投資への期待があるようだが、高機能サーバー周りで先端パッケージの投資が進むという示唆か。

A: HPC 関連の複数顧客が 5nm プロセス品の量産を拡大していく見通しに対する期待感を示したものの。

Q: 地政学的なリスクに対する言及があったが、受注環境の変化などに変化はあるのか。御社としてどのような地政学的なリスク、もしくはオポチュニティを認識しているのか確認したい。

A: 地政学的なリスクに対しては感覚を鋭くして臨んでいる。実際に昨夏、米中対立の先鋭化が当社にも影響を与えた経験を踏まえ、情報収集力を強化している。ただ当社がなすべきは、各国の法令を遵守した上で、どの地域の顧客の要求にも隔てなく当社の先端技術の提供していくことに尽きる、と考えている。

Q: 半導体ナショナリズムは、中国、欧州、米国といった地域における自前での半導体開発を促進する方向に動いていくと思う。特に中国において、既にテスタ需要の押し上げ要因となっている実態はあるか。

A: 地域別の四半期受注／売上高での説明にあるとおり、中国における需要は右肩上がりに推移している。先端半導体の開発やテストに際しては、中国地場の技術だけでは賅えず当社の製品が必要だということで、足元もかなり強い需要がある。

以上

※本資料に記載されている内容は、決算説明会の質疑をもとに当社の判断で要約したものです。また本資料には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。